

Wrocław, dnia 04.06.2019r.

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące projektu realizowanego w ramach

Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej platformy czujnikowej z łącznością bezprzewodową LPWAN zunifikowanej z systemem zarządzania inteligentnym budynkiem BMS Chronomatik.”

Zamawiający:

KMB GRUPA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Ul. Kleczkowska 50
50 – 227 Wrocław

CPV:

Kod CPV: [32573000-0](#) - Komunikacyjny system sterowania

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest 10 kompletów elementów do stworzenia platform czujnikowych.

Jeden komplet elementów składa się z następujących elementów:

Element	Ilość
kondensator 20pF, obudowa 0603	2
kondensator 100nF, obudowa 0603	5
kondensator 1μF, X5R, obudowa 0603	3
kondensator 10μF, X7R, min. 10V, min. +/-10%, obudowa 0603	2
kondensator 100nF, obudowa 0603	2
kondensator 10μF, obudowa 0805	2
kondensator 100nF, obudowa 0603	3
rezystor 0Ω, obudowa 0603	4
rezystor 10Ω, obudowa 0603	2
rezystor 100Ω, obudowa 0603	1
rezystor 120Ω, obudowa 0603	1
rezystor 220Ω, obudowa 0603	1
rezystor 10kΩ, obudowa 0603	5

rezystor 100kΩ, obudowa 0603	1
rezystor 480kΩ, obudowa 0603	1
rezystor 2MΩ, obudowa 0603	1
dioda LED, zielona, obudowa 0805	1
dioda TVS, min. 240W, 3.3V, obudowa SOD-523	1
dioda Schottky'ego, 30V, 2A, VF 375mV, obudowa DO-214AC	2
zabezpieczenie ESD, 12V, maks. 31V, 600W, obudowa SOT-23	1
koralik ferrytowy, 1kΩ, 250mA, 1.1Ω, ± 25%, obudowa 0603	3
cewka mocy 10 μH, 900mA, drutowa, Isat 1.3A	1
tranzystor MOSFET, kanał P, Id -630mA, Vds -20V, Rds 0.379Ω, Vgs 4.5V, obudowa SOT-323	3
czujnik CO2, wilgotności i temperatury	1
konwerter Step-Down, nap. wej. 10V, nap. wyj. 3.3V, obudowa SMD	1
transceiver RS485, zasilanie 3.0V-3.6V, obudowa SOIC-8	1
moduł RF, modulacja LoRa, 4.8kbps, 868MHz, czułość min. -135.5dBm, zasilanie 2.2V-3.6V, interfejsy I2C, SPI, UART, USB, obudowa SMD	1
moduł RFID/NFC, 13.56MHz, typu odczyt/zapis, pamięć min. 4kb, interfejs I2C, zasilanie 1.8V-5.5V, obudowa SOIC-8	1
antena RFID/NFC, 13.56MHz, obudowa SMD	1
kwarc 8MHz, min. ±50ppm, maks. 12pF, obudowa SMD	1
złącze pinowe, 1x4	1
złącze zaciskowe, wtykowe, rozłączalne, do druku, 2-Pin	1
złącze zaciskowe, wtykowe, rozłączalne, do druku, 3-Pin	2
pojemnik na baterie, 2xAA	1
obudowa ABS, czarna, wymiary min. 75x75x20	1

Miejsce dostawy:

KMB GRUPA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Ul. Kleczkowska 50
50 - 227 Wrocław

Maksymalny termin dostawy:

Do 14 czerwca 2019r.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o składanie ofert na realizację przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert: do 7 czerwca 2019 roku

Sposób składania ofert: na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do „Rozznania rynku – zapytania ofertowego”

Miejsce składania ofert: osobiście w siedzibie Zamawiającego (Ul. Kleczkowska 50 50 - 227 Wrocław w godzinach pracy biura: 8:00 - 16:00), pocztą lub na adres mailowy: adela.tatarzycka@kmb-serwis.pl. Decydująca jest data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

Szczegółowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Mateusz Milkowski, e-mail: mateusz.milkowski@kmb-serwis.pl lub pod numerem telefonu: 782 17 00 75.